

## 2020年7月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年6月15日

上場会社名 ウィンテスト株式会社  
 コード番号 6721 URL <http://www.wintest.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役  
 四半期報告書提出予定日 2020年6月15日  
 配当支払開始予定日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東  
 TEL 045-317-7888

(百万円未満切捨て)

### 1. 2020年7月期第3四半期の連結業績(2019年8月1日～2020年4月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年7月期第3四半期	432	41.8	498		498		560	
2019年7月期第3四半期	305	8.4	227		215		496	

(注) 包括利益 2020年7月期第3四半期 596百万円 ( %) 2019年7月期第3四半期 496百万円 ( %)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年7月期第3四半期	19.31	
2019年7月期第3四半期	38.10	

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年7月期第3四半期	2,472	2,132	86.2
2019年7月期	424	127	30.1

(参考) 自己資本 2020年7月期第3四半期 2,131百万円 2019年7月期 127百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年7月期		0.00		0.00	0.00
2020年7月期		0.00			
2020年7月期(予想)				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2020年7月期の連結業績予想(2019年8月1日～2020年7月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期									

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

#### 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有  
新規1社(社名) 偉恩測試技術(武漢)有限公司
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更         | : 無 |
| 会計上の見積りの変更         | : 無 |
| 修正再表示              | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年7月期3Q	33,041,000 株	2019年7月期	13,041,000 株
期末自己株式数	2020年7月期3Q	株	2019年7月期	株
期中平均株式数(四半期累計)	2020年7月期3Q	29,026,401 株	2019年7月期3Q	13,041,000 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

#### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。

また上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(1) 経営成績に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(四半期損益計算書関係) .....	8
(セグメント情報等) .....	9
3. その他 .....	11
継続企業の前提に関する重要事象等 .....	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大とそれに対応するための対策が経済活動を直撃し、リーマンショックを上回る規模の経済後退シナリオも示されており、全世界で大きな景気減速となりました。2020年4月末時点においては、なおも経済の回復力には力強さを欠き、この影響が実経済に与える大きさが顕在化するの5月以降であるとの指摘がなされ、2019年と同程度まで経済が回復するには向こう3年間は必要であるとの専門家の意見もあります。また、米国主導の対中国政策方針にかかわる強硬な態度と不確実性の問題が、日本およびアジア新興国経済に不安定な影を落としております。このように、世界経済は大きく疲弊しており、一日も早い回復が望まれる状況が続いています。

わが国の経済も同様に新型コロナウイルスによる経済の停滞を受け、雇用の急激な悪化、経済弱者に留まらない世帯所得の大きな落ち込みが連日のように報道され、その実態は、日を追って実社会に反映されつつあります。為替相場も円高傾向が続いており、株式市場は大きな混乱が収束していない状況が続いております。今後、景気の先行きには大きな下振れリスクをはらみ、新型コロナウイルスの感染終息後も不透明な状況が当面続くことが懸念されております。

当社グループが属する半導体並びにフラットパネルディスプレイ業界におきましても、上述したような新型コロナウイルスの与える影響は大きく、例外ではありませんが、通信の5G(ファイブ・ジェネレーション)化技術が先導役となり4K、8Kなど映像画面の高精細化だけではなく、大型液晶テレビ関連デバイス、また、これまでにデータの遅延が問題となっていた遠隔監視および遠隔制御関連市場における5Gへの期待は大きく、それらと連動する形で、「高精細表示デバイス市場」等のデバイス関連市場は、年平均成長率(CAGR)4%以上で大きく伸びると予測されています。それらの要因から、「周辺半導体市場」全般は引き続き成長が予測されていますが、新型コロナウイルスの感染終息、ワクチンの普及、加えて米中問題などの課題が残っており、当面の間、依然不安定であります。

このような環境のなか、当社グループは、中国湖北省武漢市に製造拠点を整備し、台湾の蔚華科技有限公司と強力な協力関係を築き、中国、台湾及び周辺国における営業活動を積極的に強化しました。開発面では、新規開発と既存製品の改善や使用中の電子部品の陳腐化に伴う改版に分け、新規開発は大阪事業所を中心としてR&Dと横浜の開発力をあわせた先端技術開発を担当し、既存装置の改版改善はエンドユーザと量産現場により近い当社武漢工場で行い、次々と発表される新デバイスの検査へ対応するための次世代装置の開発、拡張オプション開発および検査スピードや精度の改善をよりタイムリーに実現できる体制を目指し、新型コロナウイルス禍後の業績に大きく貢献できる体制を構築いたしました。

その結果、製品仕様の機能アップによる対応可能半導体デバイスの品種数増加および競合に対し十分な競争力を持つテストスピードと精度の両立を達成し、2020年3月5日に公表いたしましたとおり、既存の台湾顧客およびエンドユーザーを中国とする新規顧客から高い評価を受け、大口受注することとなりました。今般のコロナウイルス禍の直撃を受けた当社中国工場の一時休止の影響を極力排すべく、既存の大阪事業所の人員増強、製造体制強化を進めタイムリーな増産に努めてまいりましたが、エンドユーザーであるデザインハウスの新製品リリース予定に、新型コロナウイルス禍の影響が出始めており、出荷予定繰り下げの要請を受け、製品の出荷時期の一部が1ヶ月から2ヶ月程度遅れることとなりましたが、当社グループ第3四半期の連結累計売上は、前年同期に比較しやや増加となりました。

新規事業である新エネルギー関連事業においては、太陽光発電所のオペレーション&メンテナンス(O&M)は微増に留まりましたが、外注コストを下げるために内製化作業を増加させ、コストの低減に努めております。また新たに取組んだEPC(設計・調達・建設)は予定通り完工完成となり、順調に推移しておりますが、新型コロナウイルス禍の影響はO&Mの現場作業の遅延障害となり、今年度期末まで予断を許さない状況となっております。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の当社グループの売上高は432,736千円(前年同四半期比41.8%増)、営業損失498,860千円(前年同四半期は営業損失227,920千円)、経常損失498,223千円(前年同四半期は経常損失215,957千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失560,497千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失496,873千円)となりました。

なお、セグメントの業績は、次のとおりであります。

## ①半導体検査装置事業

半導体検査装置事業においては、製品仕様の機能アップによる対応可能半導体デバイスの品種数増加を達成し、2020年3月5日に公表いたしましたとおり、既存の台湾顧客およびエンドユーザーを中国とする新規顧客より大口受注いたしました。また、代理店によるトップ営業と当社トップ営業のタッグによる営業推進体制により、海外での売上拡大と、新規顧客の開拓に向けた積極的な営業活動を展開し、新規装置のベンチマークなど目途は立ちつつあり、確かな手応えを得るまでになっておりますが、新型コロナウイルス禍の影響は無視できなく、その後の新規受注には至りませんでした。また、同受注済みのLCDドライバIC検査装置の出荷に関し、上述のような理由から、出荷予定が1ヶ月から2ヶ月程度ずれ込む見込みであり、この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は

ウインテスト株式会社（6721）2020年7月期第3四半期決算短信（連結）

265,194千円（前年同期比19.4%増）、営業損失483,578千円（前年同四半期は営業損失184,969千円）となりました。

②新エネルギー関連事業

新エネルギー関連事業においては、今期より正式に開始したEPC事業を鋭意進めております。その結果、新規中・小規模ソーラー発電所のEPC複数受注とO&Mの受注増へとつなげることができました。O&Mは受注は微増となったものの、新型コロナウイルス禍の中ではありますが、受注済みの大規模発電所が完工を迎え、売上高は予定通り推移いたしました。この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は165,125千円（前年同期比104.6%増）、営業損失14,919千円（前年同四半期は営業損失29,057千円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ2,044,287千円増加し、2,451,982千円（前連結会計年度末比501.4%増）となりました。この主な要因は、現金及び預金が1,336,354千円増加したこと等によるものです。

固定資産は、前連結会計年度に比べ2,930千円増加し、20,137千円（前連結会計年度末比17.0%増）となりました。この主な要因は、差入保証金が3,132千円増加したことによるものです。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べ49,081千円増加し、285,274千円（前連結会計年度末比20.8%増）となりました。この主な要因は、買掛金が129,575千円増加したこと及び未払金が86,270千円減少したこと等によるものです。

固定負債は、前連結会計年度に比べ6,324千円減少し、54,525千円（前連結会計年度末比10.4%減）となりました。この主な要因は、長期借入金が5,382千円減少したこと等によるものです。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度に比べ2,004,460千円増加し、2,132,320千円（前連結会計年度末比1,567.7%増）となりました。この主な要因は、資本金が1,300,000千円及び資本準備金が1,300,000千円増加したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループは、今後、ロボット分野、IoT分野、およびオーディオ分野など新規分野に関し、事業仕分けを行い、有効分野を見極め、集中と選択の協議の後、有効分野への展開を推し進めてまいります。

新エネルギー事業領域であるオランジュ株式会社は、太陽光発電システムの保守点検・整備・保証管理（O&M）領域に加え、新たにEPC（新規設備設置事業）を始めたことで、当第3四半期中に大型発電所案件の完工に至るなど、積極的に顧客を開拓するとともに、新型コロナウイルス禍によるスローダウンを余儀なくされている、パネルのモニタリングシステム（部分影補償機能付き）の開発継続や、他社に先行するキントーンを主体とした「O&M業務管理システム」の構築、特に今後の重要課題と捉える他社大手とのアライアンスも視野に入れた事業体制構築を、当社グループ内で進めております。

また、既存事業であるCMOSイメージセンサー検査装置、並びに半導体及びフラットパネル・ディスプレイ検査装置事業につきましては、5G（ファイブ・ジーと読まれる）及びWifi 6による大容量画像データ転送技術に対応する高精細パネルの台頭、スマホの2画面化並びに拡大傾向を受け生産数量は、特に新型コロナウイルス禍後の数年間は4%以上のCAGR（年平均成長率）が続き（IHI調べ）、高機能化に伴う検査時間の増大へ対応するための、設備投資が主に中国、台湾で見込まれており、当社は引き続きエンジニアと営業が連携した活動、そして当社中国工場の機能を最大限活用し、積極的に展開してまいります。

このように、当社グループの半導体検査装置事業は改善の兆しが見られますが、新型コロナウイルス禍の影響から、エンドユーザのデバイスリリースに予期せぬ時間を要することとなり、受注済み出荷月が1ヶ月から2ヶ月程度ずれ込む見込みであり、当連結会計年度の受注・売上高を保守的に見積もる必要があると判断しております。

通期の業績予想に関し、2020年1月1日に設立した当社中国工場では新型コロナウイルス禍の影響で3か月程度の休止を已む無くされました。また今期末までの出荷売上予定として、既に約1,050百万円を受注しておりますが、上述のような理由からエンドユーザと今後の出荷予定に関し調整を行っており、現時点で通期の業績予想が難しくなりました。

新型コロナウイルスの終息時期の見通しは不透明であり、内外経済の減速による当社業績への影響が拡大するリスクがある状況と認識しております。今後の動向を見極めつつ対応策を検討してまいります。現時点において、業績への影響額を合理的に見積もることは困難であることから、当社が2019年9月15日に公表いたしました、2020年7月度連結決算予想を一旦未定といたします。

なお、業績予想につきましては、今後、適切かつ合理的な見積りが可能となった時点で速やかに公表いたします。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年7月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年4月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	93,098	1,429,452
受取手形及び売掛金	42,265	153,352
商品及び製品	50,751	117,825
仕掛品	79,851	373,220
原材料及び貯蔵品	78,902	271,919
前渡金	780	18,880
その他	62,046	87,330
流動資産合計	407,694	2,451,982
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物（純額）	—	—
車両運搬具	9,163	8,885
減価償却累計額	△9,163	△8,885
車両運搬具（純額）	—	—
工具、器具及び備品	183,739	183,739
減価償却累計額	△183,739	△183,739
工具、器具及び備品（純額）	—	—
リース資産	4,391	4,391
減価償却累計額	△4,391	△4,391
リース資産（純額）	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	20,591	23,521
貸倒引当金	△3,384	△3,384
投資その他の資産合計	17,207	20,137
固定資産合計	17,207	20,137
資産合計	424,902	2,472,119

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2019年7月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年4月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	19,462	149,038
未払金	102,634	16,364
短期借入金	25,000	25,000
1年内返済予定の長期借入金	7,176	7,176
未払法人税等	10,688	17,359
賞与引当金	1,800	8,772
前受金	39,684	24,344
その他	29,747	37,220
流動負債合計	236,192	285,274
固定負債		
長期借入金	46,588	41,206
その他	14,261	13,319
固定負債合計	60,849	54,525
負債合計	297,042	339,799
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,654,325	2,954,325
資本剰余金	1,761,574	3,061,574
利益剰余金	△3,288,040	△3,848,538
株主資本合計	127,859	2,167,361
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	—	△35,877
その他の包括利益累計額合計	—	△35,877
新株予約権	—	836
純資産合計	127,859	2,132,320
負債純資産合計	424,902	2,472,119



（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 （四半期連結損益計算書）  
 （第3四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第3四半期連結累計期間 （自 2018年8月1日 至 2019年4月30日）	当第3四半期連結累計期間 （自 2019年8月1日 至 2020年4月30日）
売上高	305,118	432,736
売上原価	181,194	428,315
売上総利益	123,924	4,421
販売費及び一般管理費	351,844	503,281
営業損失（△）	△227,920	△498,860
営業外収益		
受取利息	5	517
補助金収入	10,955	—
その他	2,518	1,561
営業外収益合計	13,479	2,078
営業外費用		
支払利息	919	1,035
支払手数料	517	357
その他	79	48
営業外費用合計	1,516	1,441
経常損失（△）	△215,957	△498,223
特別損失		
減損損失	※ 279,829	※ 59,654
特別損失合計	279,829	59,654
税金等調整前四半期純損失（△）	△495,786	△557,877
法人税、住民税及び事業税	1,086	2,620
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	1,086	2,620
四半期純損失（△）	△496,873	△560,497
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△496,873	△560,497

(四半期連結包括利益計算書)  
(第3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年8月1日 至 2019年4月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年4月30日)
四半期純損失(△)	△496,873	△560,497
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	—	△35,877
その他の包括利益合計	—	△35,877
四半期包括利益	△496,873	△596,375
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△496,873	△596,375
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は2019年9月25日付で、武漢精測電子集団股份有限公司から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本金が1,300,000千円、資本準備金が1,300,000千円増加し、第3四半期連結会計期間末において、資本金が2,954,325千円、資本準備金が3,061,574千円となっております。

(四半期連結損益計算書関係)

※ 減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

I 前第3四半期連結累計期間(自2018年8月1日至2019年4月30日)

場所	用途	種類	減損損失 (千円)
大阪府大阪市	半導体検査装置事業 関連資産	建物附属設備	3,475
		工具器具備品	257
		電話加入権	432
		ソフトウェア	3
		のれん	274,192
神奈川県横浜市		工具器具備品	1,468

当社グループは管理会計上の区分を基礎として、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとにグルーピングを行っております。

半導体検査装置事業においては、営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、今後も収益改善の可能性が低いと判断した資産は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は零と見積もっております。

II 当前第3四半期連結累計期間(自2019年8月1日至2020年4月30日)

場所	用途	種類	減損損失 (千円)
神奈川県横浜市	半導体検査装置事業 関連資産	工具器具備品	6,300
		ソフトウェア	252
	新エネルギー関連事業 関連資産	車両運搬具	1,990
		工具器具備品	1,271
		リース資産	729
大阪府大阪市	半導体検査装置事業 関連資産	建物附属設備	1,400
		工具器具備品	784
		リース資産	1,029
中国湖北省武漢市	半導体検査装置 関連資産	建物附属設備	45,897

当社グループは管理会計上の区分を基礎として、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとにグルーピングを行っております。

半導体検査装置事業及び新エネルギー関連事業関連資産においては、営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、今後も収益改善の可能性が低いと判断した資産は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は零と見積もっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自2018年8月1日至2019年4月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)3	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	半導体検査 装置事業	新エネルギー 関連事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	222,173	80,718	302,892	2,226	—	305,118
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	222,173	80,718	302,892	2,226	—	305,118
セグメント損失	△184,969	△29,057	△214,026	△15,423	1,530	△227,920

(注) 1. セグメント損失の調整額1,530千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位:千円)

	半導体検査装置 事業	新エネルギー 関連事業	計	その他	全社・消去	連結財務諸表 計上額
減損損失	279,829	—	279,829	—	—	279,829

II 当第3四半期連結累計期間(自2019年8月1日至2020年4月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注) 3	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	半導体検査 装置事業	新エネルギー 関連事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	265,194	165,125	430,319	2,416	—	432,736
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	265,194	165,125	430,319	2,416	—	432,736
セグメント損失	△483,578	△14,949	△498,528	△1,861	1,530	△498,860

(注) 1. セグメント損失の調整額1,530千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(単位:千円)

	半導体検査装置 事業	新エネルギー 関連事業	計	その他	全社・消去	連結財務諸表 計上額
減損損失	55,663	3,991	59,654	—	—	59,654

### 3. その他

#### 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度においては、営業損失348,737千円を計上、更に昨年3月に山田電音株式会社から譲受けした大阪事業所にかかるのれん等の減損損失294,183千円が加わり、親会社株主に帰属する当期純損失633,003千円を計上し、営業キャッシュ・フローは268,348千円のマイナスとなりました。また、当第3四半期連結累計期間においては、当社グループの半導体検査装置事業については、3月に台湾の販売代理店から大口受注を獲得し、今後、順次納品してまいります。売上高は前年同期比43,020千円の増加にとどまりました。また新エネルギー関連事業については、主業務のメンテナンスサービスに加え新規設置工事が増加し、売上高は前年同期比84,406千円増と、大幅に増加しました。

よって、当社グループの連結ベース売上高は、432,736千円にとどまり、大阪事業所の労務費、販管費も加わり営業損失498,860千円、親会社株主に帰属する四半期純損失560,497千円を計上しております。

当該状況により、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を解消するため、以下の取組みを継続して実施しております。

まず、半導体検査装置事業では、数年前よりスマートフォン向け半導体分野への積極的な設備投資が続いてきたアジア圏(台湾及び中国)に新たな商機を求め、現地の顧客ニーズに適合したLCDドライバーIC検査装置を開発するとともに、新顧客の開拓に注力しており、その結果、当該検査装置については、検査コストの低減に繋がる効率的な機能が評価されており、前連結会計年度には中国市場にブレークインを果たし、当第3四半期連結累計期間には追加の大口受注を獲得しました。2019年12月に巨大な検査装置マーケットである中国に当該検査装置の組立工場として「偉恩測技術(武漢)有限公司」を設立するとともに、2020年2月には、営業とアフターサポート体制の拡充と強化を目的に販売代理店である台湾の「蔚華科技股份有限公司」と資本提携契約を結び、強固な関係を築き更なる受注に向けた営業活動を行ってまいります。

なお、中国武漢市に設立した前記の現地法人は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け当年初から稼働停止していましたが、4月から稼働を再開しており、これまで製造を担ってきた大阪事業所の拡充、生産体制の整備と併せて増産に向け鋭意努力をしております。現在、新型コロナウイルスに係る影響は、当社の製造能力については限定的であります。

また、台湾、中国顧客向けに開発中の汎用ロジックテスターについては、より広範囲のロジックIC検査に対応するためアナログオプションなどの追加機能を開発しており(TDDI対応など)、それを強みとして当年中には受注を見込んでおります。

次に、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用、且つ今回、事業譲渡を受けた開発部門の技術陣と協働し、自重補償機構を使ったFA分野、オーディオ分野、IoTを使ったヘルスケア(セルフケア)方面を視野に入れた新成長事の業分野へ、シナジーの高い事業会社との資本・業務提携、並びに産学連携を積極的に進め、進捗によっては当該分野への新規参入、事業の多角化展開を図り収益基盤の拡充に取り組んでまいります。そのうち自重補償機構技術については、慶應義塾大学と共同開発を進めて、前連結会計年度に完成した試作3号機の成果を使った、当社検査装置向けの「ポゴタワー搬送マニピュレータ」を製品化する方向で進めております。今後も技術的な問題を解決し、FA機器やパワーアシスト機器等への応用を目指してまいります。更に、IoT分野では太陽光パネルの発電効率向上に役立つモニタリングシステムの製品化を行っており、当社連結子会社である太陽光発電所の発電パネルのメンテナンス事業を手がける当社100%子会社のオランジュ株式会社と連携してまいります。

なお、オランジュ株式会社の手掛ける当該事業分野では、2017年4月からの改正FIT法施行に伴って電力の安定供給に係る太陽光発電パネル等の保守管理が義務化の方向を端緒として、昨今、事故防止面でも高精度、高効率なメンテナンスニーズが更に増しており、問い合わせの増加が顕著になっていることから、広範囲な顧客開拓に注力しており売上増に繋がっているところです。

また、経費水準は事業譲渡を受けた大阪事業所、並びに2019年12月に設立した偉恩測技術(武漢)有限公司の運転資金等により増加しておりますが、製品の製造委託コストや部材調達に関し、製造委託コストに代わり内製の体制を構築したことで、よりスピーディで顧客満足度の高いサービスの提供ができるとともに、大幅なコスト削減に成功、また製品やサポートの品質向上を行い大量受注への体制の整備が整いつつあります。

財務面については、2019年7月31日には中国の販売代理店である、武漢精測電子集団股份有限公司と資本提携契約を締結し、同日開催の取締役会において同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、2019年9月25日に2,600百万円の資金調達を実施しました。これにより、今後の検査装置事業に必要な中国における工場や拠点設立資金及び開発、運転資金並びに新規事業の展開資金を確保するとともに、併せて財務基盤の強化を図りました。

現在、主に中国における新型コロナウイルスの感染状況の影響が検査装置事業にとって不透明材料であるものの、以上のとおり、台湾、中国を中心とするビジネス機会や受注が増加していること及び今後の運転資金に必要な現預金を確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。